

芯联集成电路制造股份有限公司

关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的

半年度评估报告

2025 年上半年，公司依托并强化“一站式芯片系统代工”模式，精准对接重点客户的战略需求；同时，不断加大研发投入，持续推出具有稀缺性的工艺技术平台，构筑技术领先性；升级精细化管控体系与优化战略性资源配置，全面提升经营质量；强化股东权益保护机制，构建长期资本增值路径，转化企业成长动能；将股权激励深度融入公司成长规划，实现风险共担、价值共创，为可持续发展奠定坚实基础；全面启动并推进“提质增效重回报”专项行动，各项举措落地见效。

一、强化芯片系统代工商业模式，打造特色代工优势

2025 年上半年，公司在晶圆代工模式的基础上，不断汲取市场需求的变化，强化“一站式芯片系统代工”的经营模式，构建了覆盖多个关键技术平台的产品矩阵，精准服务于高速增长的应用市场。

报告期内，公司实现主营收入 34.57 亿元，同比增长 24.93%；归母净利润 -1.70 亿元，同比减亏 63.82%，其中二季度归母净利润 0.12 亿元，首次实现单季度转正；毛利率 3.54%，较上年同期增加 7.79 个百分点；息税折旧摊销前利润（EBITDA）11.01 亿元，息税折旧摊销前利润率 31.51%。

2025 年下半年，公司将立足于现有的核心芯片与模组的技术水平与一站式芯片系统代工模式，继续深耕芯片和模组代工领域。同时，深化与合作伙伴的战略协同，加强与核心战略供应商的合作关系，通过协同降本提效、共享新产品研发机遇与价值，来巩固成本竞争优势，从而提升市场竞争力并增强公司的可持续发展能力。

二、强化技术研发与成果转化能力，构建协同创新体系

2025 年上半年，公司确立了功率、MEMS、BCD、MCU 四大主要技术方向，在新能源汽车，风光储，电网和水利工程、数据中心等新基建项目，高端消费领域所需要的产品上，持续研发先进的工艺及技术。同时，公司坚持走核心技术自主研发的道路，以追求极致产品性能为目标。以高研发投入驱动技术储备及技术转

化，持续激发创新动能，形成覆盖全产业链的知识产权护城河。

报告期内公司研发投入为 9.64 亿元，占营业收入的 27.59%。本期新增申请专利 119 项，新增获得专利 52 项。截至报告期末，公司累计申请专利等 1,144 项，获得专利等 468 项。

在研发成果转化上，车载应用方面，功率器件领域相关产品关键指标均处于国际先进水平，大范围获得国内外主流车厂和 Tier1 的定点；车载模拟 IC 已推出多个国内领先、全球先进的技术平台，填补国内空白，获得重要客户定点。工控应用方面，率先推出引领行业方向的新一代芯片及模块，并陆续与主要客户开展合作。高端消费方面，公司部分产品已经占据市场和技术领先地位；提前布局第三代半导体在家电领域应用，为客户定制能效升级应对方案；通过持续技术升级和产品迭代，公司产品市场占有率大幅提升。AI 方面，部分产品已进入量产；发布了芯片制造平台，获得关键客户的产品导入。

2025 年下半年，公司将继续通过聚焦核心目标、优化研发管理体系、强化关键节点管控、提升研发效率，在产品技术的研发与创新上投入核心资源，推出新技术与新产品，驱动公司技术进步和产品迭代升级。

三、通过并购重组加速优势资源整合，深化产业协同与生态共建

2025 年上半年，为推动公司产业整合，集中优势资源重点支持碳化硅等新兴业务发展，对硅基业务进一步管控整合，发挥协同和规模效应，强化公司的核心竞争力。报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产事项已获批准，将加速推动公司深度整合的进程，也将助力公司快速崛起。

2025 年下半年，公司将深入分析新能源汽车、光伏储能等不同行业碳化硅产品的具体需求，确保产品开发与市场需求的精准对接；公司将加大资源投入，积极推动产品在目标客户的量产导入，扩大市场份额；与客户共同开发完整解决方案，探索碳化硅产品在智能电网等新兴或高潜力领域的应用可能性，寻找新的增长点，突破传统市场边界；建立基于信任、互利共赢的长期战略合作伙伴关系，通过共同研发、技术交流等方式，实现深度绑定；与供应商建立紧密的协同机制，提升供应链的韧性和抗风险能力。公司将进一步聚焦于市场应用的突破性拓展、供应链韧性与竞争力的深化以及产业生态的协同共建三个关键维度，巩固竞争优势，为公司下一阶段的高速发展奠定坚实基础。

四、股权激励深化人才战略，强化市值管理夯实高质量发展根基

2025年上半年，公司根据审议结果，向符合预留授予条件的354名激励对象授予2,291.60万股第二类限制性股票。激励对象主要为公司中高层管理人员、核心技术（业务）骨干等。公司股权激励计划的积极进展，是公司人才战略和长期激励体系成功运行的有力证明。不仅有效保留和激励了核心骨干力量，增强了团队的凝聚力和战斗力，也为公司未来的持续创新和高质量发展奠定了坚实的人才基础，将为公司带来积极的人才效应和经营成果。

报告期内，公司董事会审议通过了《芯联集成电路制造股份有限公司市值管理制度》，切实强化公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司及投资者的合法权益。

2025年下半年公司将根据市场情况，在必要的情况下，适时采取相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定。在达到分红条件后，结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定相应的分红方案，以实质回报投资者。

五、积极拥抱 AI 工具，开启公司智能未来

伴随 AI 浪潮对企业生产经营、客户服务、内部管理及战略决策等各个方面的渗透，公司积极拥抱 AI，将其融入战略核心，构建起基于 AI 的核心竞争力。

2025年上半年，公司已搭建内部 AI 大模型，从技术能力提升、数据安全、成本控制等多方面战略价值进行深度挖掘，提高公司的长期、可持续的竞争优势。在辅助芯片设计服务和工艺开发方面，公司利用 AI 技术提升实验效率，以更高效率实现更高功率的工艺平台研发、实现成本下降；在质检方面，AI 辅助工厂实现自动化缺陷检测，大幅降低人力成本；在办公和协同效率方面，公司通过 AI 搭建知识库和智能体，实现任务和流程自动化；在生产方面，公司利用 AI 辅助数据分析，提升生产过程中问题分析效率及工艺优化能力。

2025年下半年，公司将全面推动 AI 技术与核心业务的深度融合，基于 AI 相关技术，重构研发、生产、服务全链路智能化体系，驱动供应链优化，提升服务效率，赋能产品创新，贡献营收和服务增量，并加速公司在四大应用方向的垂直渗透。

六、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将聚焦高价值产业链，专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025年8月1日